TEC™ 153

Jednoskładnikowy klej MSPS, szybko polimeryzujący, bez rozpuszczalnika, nakładany szpachelką ząbkowaną, do pełnego klejenia parkietów.

ZALETY

- Nie zawiera izocyjanianu ani silikonu - Ulega sieciowaniu w kontakcie z wilgocią z powietrza i podłoży
- Elastyczne utwardzanie warstwy kleju po związaniu - Zachowuje dobrą ścisłość
- Poprawia komfort akustyczny parkietów
- Klej łatwy do nakładania - Nieagresywny wobec lakierów
- Nadaje się do stosowania na podłogi z ogrzewaniem niskotemperaturowym

UŻYWANIE

TEC™ 153 jest stosowany do pełnego klejenia wszystkich rodzajów parkietów litych, w tym o dużych rozmiarach (szerokość klepek do 15 cm - warstwowych i innych… Podkład izolujący z aglomeratu korkowego.
Umożliwia w szczególności układanie litego parkietu z drewna egzotycznego, również w trudnych warunkach (podłogi z ogrzewaniem, łazienki itp.)
TEC™ 153 zapewnia dużą siłę wiązania, również bez gruntu, na większości zwykle stosowanych podłoży budowlanych, takich jak tradycyjna posadzka cementowa, płynny jastrych cementowy lub anhydrytowy, podłoga betonowa, panele z aglomeratu drewnianego (sklejki do użytku na zewnątrz pomieszczeń – sklejki odporne na wilgoć).

Ważne: W przypadku podłóg ze zintegrowanym ogrzewaniem (ciepła woda) obowiązkowe jest pełne klejenie parkietu.
Przed układaniem parkietu z drewnianych klepek i/lub drewnianych płyt: prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej

W razie wątpliwości dotyczących możliwych zastosowań prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Podstawa	Żywice polimerowe
Kolor	Beż
Gęstość	1,46
Czas pracy	Ok.: 60 minut
Zużycie	od 800 do 1500 g/m² w zależności od zastosowania *(szpachelka TKB B3 lub B11)*
Możliwość ruchu pieszego	Po upływie 24 godzin*
Szlifowanie i witryfikacja	Szlifowanie i obróbka parkietu po 48 godzinach w temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej 50%
Definitywne związanie	Po upływie od 5 do 7 dni*
Minimalna temperatura użytkowania	+15°C
Przechowywanie	9 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym panują umiarkowane warunki – Chronić przed mrozem
Pakowanie:	15 kg / pojemnik zawierający 3 torby po 5 kg
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie.

* Wyżej wymienione wartości zostały ustalone laboratoryjnie i należy je traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę możliwą zmienność warunków stosowania (chłonność podłoża, temperaturę, wilgotność itp.)

PODŁOŻA

- Podłoża powinny być spójne, jednorodne, pozbawione tłuszczu i kurzu.
- Ponadto powinny się charakteryzować doskonałą stabilnością, być płaskie, trwale suche, niepodsiąkające, idealnie przylegające do podłoża nośnego.
- Powinny mieć również odporność powierzchniową na ścieranie wynoszącą co najmniej 0,5 MPa

Ogólnie, powinny być pozbawione jakichkolwiek produktów, które mogłyby zakłócić przyleganie ewentualnego gruntu oraz kleju: kurzu, cząstek nieprzylegających lub słabo przylegających, śladów tłuszczu, oleju, farby, rdzy, rzadkiego zaczynu, wosku, środków konserwacyjnych, materiałów zawierających lekkie oleje, plastyfikatorów lub przeciwutleniaczy: preparatów utwardzających lub środków do rozszalowywania, asfaltu, paku, silikonu, starych klejów

- Podłoże powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (francuskie prawo budowlane (normy DTU), specyfikacje techniczne i wytyczne). W razie braków podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Wymagania dotyczące płaskości umożliwiającej ułożenie klejonego parkietu na podłożu stworzonym z użyciem środków wiążących to 5 mm pod łatą o długości 2 m i 1 mm pod przymiarem 0,20 m. Jeżeli wymaganie to jest zachowane, dozwolone jest klejenie bezpośrednie. W przeciwnym wypadku powinno się zastosować podkład podłogowy P3 lub P4 z naszej oferty.

- Podłoża z drewna lub paneli wiórowych: nakładać klej bezpośrednio, bez uprzedniego stosowania podkładu.
- Jastrych anhydrytowy: nakładać klej bezpośrednio.
- Inne podłoża: prosimy o kontakt
- Przy przygotowywaniu podłoży stosować się do informacji zawartych w dokumentacji technicznej poszczególnych produktów

WARUNKI UŻYCIA

Uwaga: pomieszczenie, w którym ma zostać położony klejony parkiet, powinno być klimatyzowane, aby zapewnić najlepsze warunki układania. Z tego względu należy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących układania określonych przez DTU 51.2

Ograniczenia dotyczące temperatury	Nie należy nakładać produktu podczas mrozu lub dużych upałów (Idealna) temperatura otoczenia powinna wynosić od +15 do +25°C Nie należy nakładać produktu na podłogę, która jest ogrzewana. Ogrzewanie należy wyłączyć przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem prac
Temperatura podłoża podczas nakładania oraz do momentu całkowitej polimeryzacji kleju TEC™ 153	Minimalnie +15°C w przypadku podłogi bez ogrzewania Maksymalnie +20°C w przypadku podłogi z ogrzewaniem
Dopuszczalna wilgotność przez cały czas układania parkietu	Powinna być zawarta w zakresie od 45% do 65%. Wilgotność powietrza i temperatura podłoża powinny być takie, aby nie następowała kondensacja na poziomie podłoża (punkt rosy).

ZASTOSOWANIE

Ważne: W celu zoptymalizowania warunków układania parkietu, przed przystąpieniem do układania zalecamy wykonanie następujących czynności:

- Pozostawić klej TEC™ 153 w temperaturze panującej w pomieszczeniu na co najmniej 24 godziny.
- Przechowywać parkiet w pomieszczeniu *(suchym i przewietrzanym)*, w którym będzie układany na co najmniej tydzień.

Powinien on być starannie ułożony na płask, w oryginalnym opakowaniu, a przede wszystkim chroniony przed bezpośrednim kontaktem z podłożem.

- Nakładać klej w zwykły sposób, przez proste przyklejenie do podłoża, za pomocą szpachelki o większych lub mniejszych ząbkach, w zależności od jakości podłoża i rodzaju parkietu. Dostosować ilość nakładanego kleju w taki sposób, aby zapewnić jego właściwe przeniesienie na spód parkietu. Sprawdzać w trakcie pracy stan zużycia ząbków i w razie potrzeby wymienić narzędzie.
- Układać parkiet natychmiast na warstwie wilgotnego kleju, wywierając nacisk powiązany z ruchami tam i z powrotem. Lekko dobić. Sprawdzić, czy spód parkietu jest wystarczająco „zwilżony" w celu zapewnienia optymalnego przeniesienia kleju.
  Uwaga: Należy kleić tylko taką powierzchnię, której rozmiar, biorąc pod uwagę czas pracy, umożliwi przeniesienie kleju na spód parkietu przy jego układaniu; nie powinno następować tworzenie się błony na powierzchni kleju.
- Zachować od 10 do 15 mm odstępu na obwodzie pomiędzy pokryciem a elementami pionowymi (przegrody, ściany, słupy itp.).
- Podkład korkowy: układanie podkładu korkowego wykonuje się z użyciem naszego kleju TEC™ 153. Przed położeniem parkietu zaczekać na całkowite wyschnięcie kleju (48 godzin)
- Szlifowanie i lakierowanie jest możliwe po upływie od 48 do 72 godzin
- Natychmiast po użyciu przystąpić do czyszczenia narzędzi oraz świeżych plam za pomocą naszego produktu swift®clean 9695. Klej po stwardnieniu można usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi
- Ruch pieszy może się rozpocząć po upływie 24 godzin. Definitywne związanie wymaga od 48 do 72 godzin. Pokrycie można wówczas udostępnić do normalnego użytkowania.

Zalecenia:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z francuskim prawem budowlanym (normy DTU), specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi zasadami branżowymi, według dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów, przestrzegając wytycznych dotyczących układania podanych przez producenta pokrycia, zalecanych w instrukcji użycia, dokumentacji technicznej oraz innych dokumentach.